



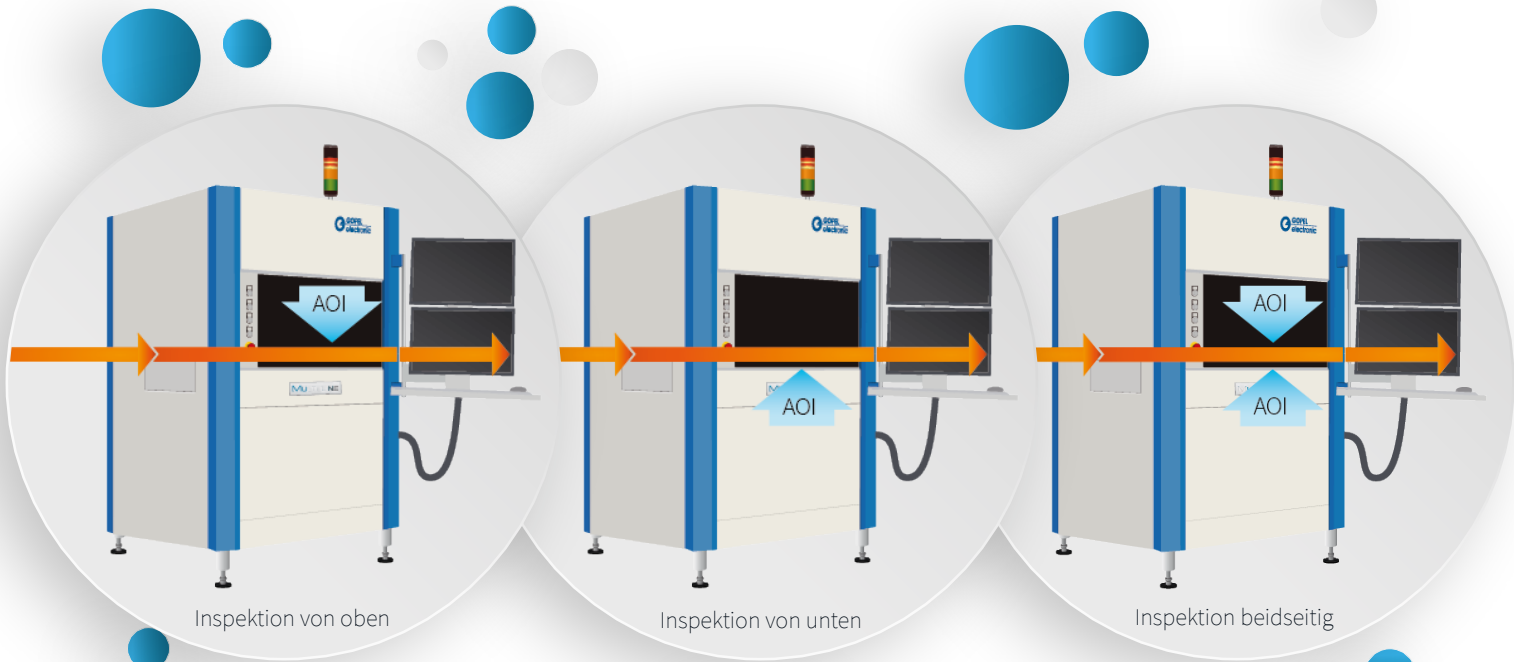
# Multi Line AOI für SMD

## AOI-System für SMD-Baugruppen



- kosteneffizientes 3D-AOI-System für den Inline-Einsatz
- für beidseitige, zeitgleiche Inspektion konfigurierbar
- vollautomatische AOI-Programmerstellung mit MagicClick in wenigen Minuten
- flexible Datenschnittstellen zur Linienkommunikation sowie für MES und Traceability
- einsetzbar als vollwertiges 3D-SPI-System

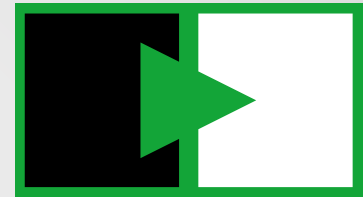




Parameter	Daten
Kameramodul	3D AOI
Bildaufnahme	3D/2D-Kameramodul mit orthogonaler Kamera, telezentrischer Optik und 3D-Bildaufnahme-Sensorik
Auflösung pro Bildpunkt	15 µm
max. Inspektionshöhe	35 mm
Bauteilfreiheit	40 mm
Einsatzmöglichkeit im Multi Line	Bauteil- und Lötstelleninspektion von oben und von unten

### Multi Line Plattform

max. Inspektionsbereich	540 mm x 450 mm
max. Werkstückträgergröße	bis zu 620 mm x 510 mm
max. Transportgewicht	15 kg
Energiebedarf	230 VAC / 2 kVA, Druckluft 6 bar, Verbrauch < 20 l/h
Transportsystem	Bandtransport für Baugruppen mit oder ohne Werkstückträger
Transportrichtung	links-rechts, rechts-links, links-links, rechts-rechts
Inline-Schnittstelle	SMEMA, HERMES, Siemens, Sensor
Abmessungen (B x T x H)	1150 mm x 1300 mm x 1800 mm
Gewicht	ca. 800 kg



**IPC-HERMES-9852**  
The global standard for "M2M" in SMT assembly

